



Patented

Application

Bonding ボンディング

ニッケルフォームの積層接合

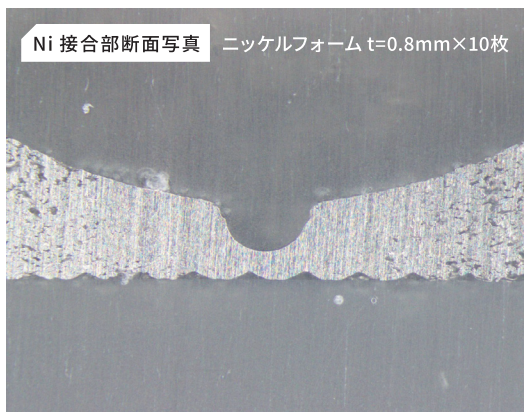
MSB (Multi Step Bonding) で複数枚・複数ヶ所 同時接合



発泡ニッケル積層シートの2カ所同時接合



Ni 接合部断面写真 ニッケルフォーム t=0.8mm×10枚

クリップ合金接合
Clip-Ingot Tool

CIBのツールの先端形状は丸みを帯びておりエネルギーが集中します。これまでのメッシュツールによる接合とは異なり、ホットキスで綴じた様な傷跡が残らずコンタミが発生しないソフトタッチの〈綺麗〉な接合方法です。

進化したMST
Multi-Step Tool

MSTでは丸みを帯びた先端形状が多段に重なりエネルギーがより先端部に集中し、スムーズに接合することができます。その結果〈接合時間を短縮でき、積層箔へのダメージをより軽減し、接合音が小さくなり、接合強度が更に増し〉ます。

Product used 使用する装置

15MZs



AP-J-0100A4-2021081901